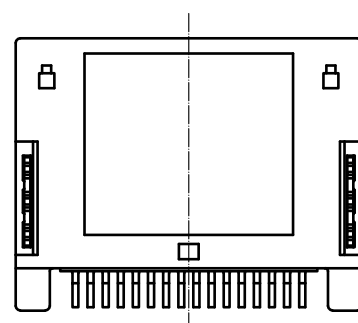
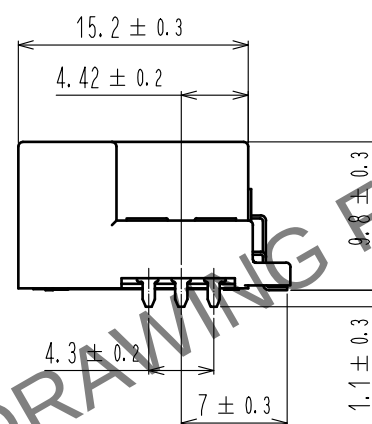
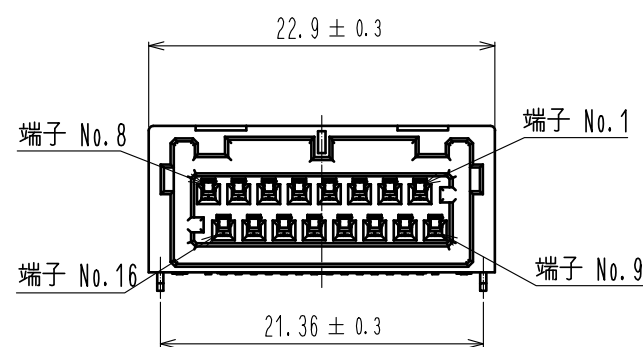
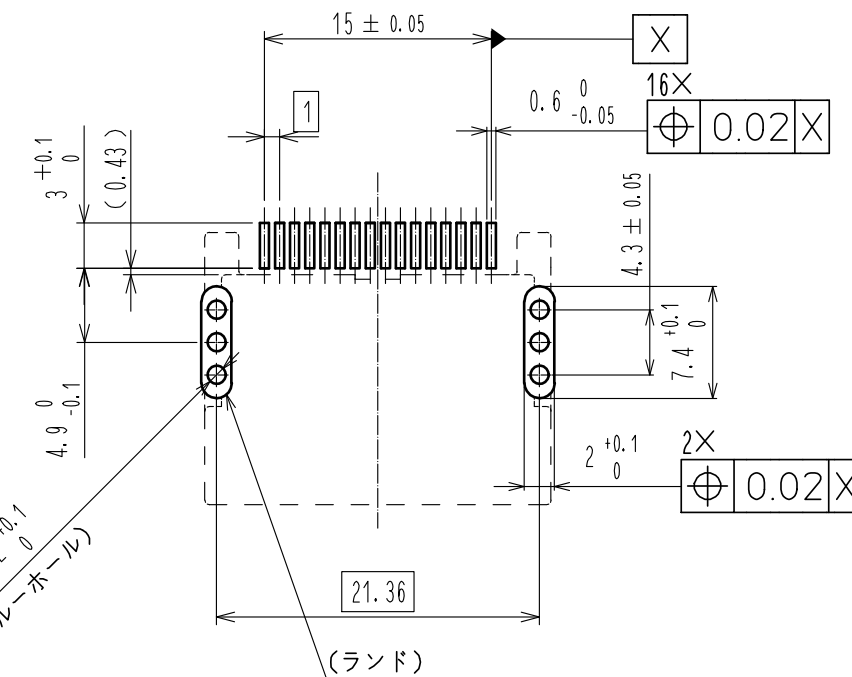
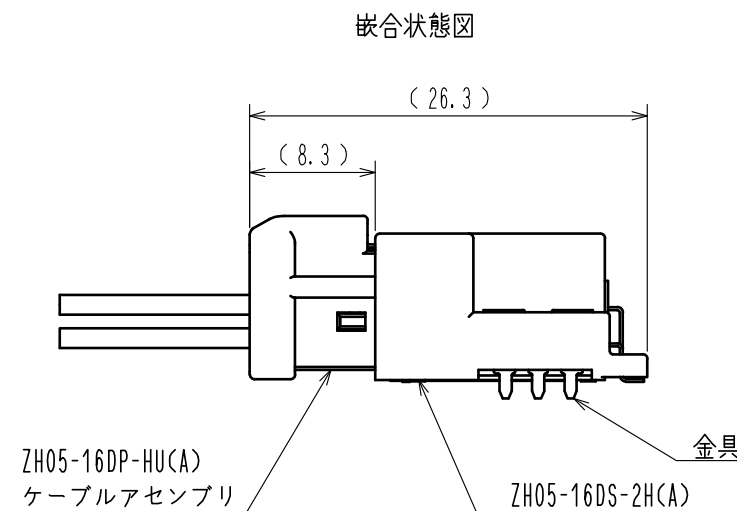
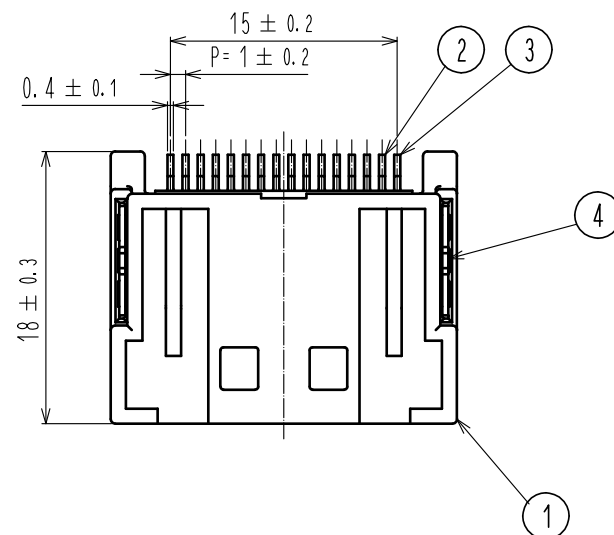
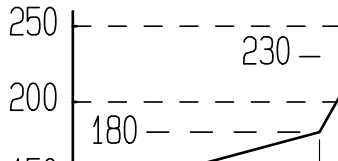
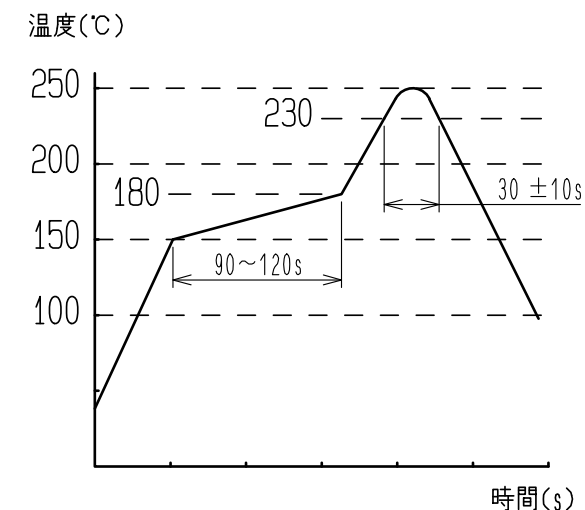


推奨基板寸法図 (FREE)
(基板厚: $t=1.6\text{mm}$, メタルマスク厚: $t=0.1\text{mm}$)



- 注1. 推奨温度プロフィール（右表参照）
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線、エア－大気中または窒素中
リフロー回数：2回
ピーク温度：250℃
230℃以上：20~40s
プリヒート温度：150~180℃
90~120s
2. 手ハンダ/ハンダこて温度
：280~300℃，2S 以内
3. 端子平坦度は0.1mm 以下とする。
4. 推奨基板厚は $T=1.6\text{mm}$ とする。
5. 推奨はんだ厚は0.10mmとする。
6. 実装時の状況により、実装部の温度上昇が抑えられはんだが溶融しない場合がございます。
その際、はんだを溶融させるためにリフロー温度を上昇させると、
ハウジングに250℃以上の過剰な熱が加わりプリスターが発生する恐れがございます。
実装時はハウジング表面が250℃を超えないことをご確認をお願いいたします。
- 



3	銅合金	表面：すずめっき 1μm min							
		下地：ニッケルめっき 1μm min	6	ポリエステル					
2	銅合金	表面：すずめっき 1μm min	5	ポリスチレン					
		下地：ニッケルめっき 1μm min							
1	PA	黒, UL94V-0	4	黄銅					
NO.	MATERIAL	FINISH ,	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH ,	REMARKS		

UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE

	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : AH. EDASHIGE	20230111	DRAWING NO.	ADC-386853-00-01
		CHECKED : TY. MOGI	20230111	PART NO.	ZH05-16DS-2H(A)
		DESIGNED : AN. SAIKI	20230110	CODE NO.	CL0756-2101-0-00
		DRAWN : AN. SAIKI	20221215		

